

# 會議論文徵稿通知 – ISPD 2024

ACM 國際實體設計技術研討會

致敬 Martin D. F. Wong 黃定發教授

2024 年 3 月 12 至 15 日 台北 <https://ispd.cc/>

ACM SIGDA / IEEE CEDA 聯合贊助

國際實體設計技術研討會提供與會者一個頂尖論壇，以交流意見並促進創新研究，主題涵蓋 ASIC 和 FPGA 傳統實體設計技術以及新興技術於本領域之效應與挑戰。ISPD 2024 將採實體會議形式於台北舉辦，並為與會者提供簡報視頻。第 33 屆會議將突顯嶄新重點方向與前瞻理論與實驗貢獻，歡迎各界踴躍投稿。

## 徵稿實體設計主題包括但不限於：

佈局規劃和連線規劃	與系統和邏輯階層設計的交互作用
分割、擺置和繞線	時序和功耗估算、建模與優化
時脈與電源網絡	實體設計環境中的電路分析與優化
布局後與矽後優化	數據管理、多執行緒/分散式演算法
製造可行性和良率的實體設計與優化	熱門主題如機器學習與硬體安全
實體合成	3D 堆疊、量子電路與其他新興技術的實體設計

## 重要時程

標題和摘要繳交截止日期	2023 年 9 月 24 日
完整的稿件繳交截止日期	2023 年 9 月 30 日
論文接受通知	2023 年 11 月 1 日
論文完稿與講者註冊期限	2024 年 1 月 12 日
會期	2024 年 3 月 12 至 15 日

## 投稿方式

所有論文必須透過網站 <https://easychair.org/conferences/?conf=ispd24> 進行電子投稿。詳情將在網站 <https://ispd.cc/> 上公告。作者將被要求上傳完整原創論文，至多 8 頁之 PDF 檔案並採用 ACM 會議格式 <https://www.acm.org/publications/proceedings-template>。違反上開頁數格式及下列要求將導致論文被拒絕。

已發表的論文或同時投稿至其他會議/期刊的論文將不予考慮。若相關論文先前已經發表或同時投稿至他處，作者應明確說明這些論文與當前投稿的論文之間的差異。所有投稿的論文都將進行盲審，因此不得在稿件的任何地方揭露作者姓名或所屬機構。並應以第三人方式論述作者先前的論文。鼓勵提供開源軟體之研究成果，但請勿提供非匿名軟體之連結，請於論文中指出開源貢獻。

會議論文集將收錄於 ACM Digital Library。ISPD 設有最佳論文獎表彰優秀的貢獻，於投稿論文中遴選。將頒發獎金一千美金與獎牌予最佳論文獎論文，另設五百美金予最佳論文候選論文。

每篇接受論文的演講者必須註冊、提供簡報檔與錄製簡報視頻並參加實體會議討論。簡報將於大會網頁公開，簡報與視頻版權歸作者所有，簡報視頻將收錄於 ISPD 2024 Youtube 頻道。

被收受論文之所有合著者受 [ACM 出版物政策](#) 的約束，包括 [涉及人類參與者和受試者的研究](#)。違規行為將由 ACM 進行調查，並可能導致論文完全撤回，以及其他潛在的處罰。ACM 要求被接受論文之作者必須獲得 [ORCID ID](#) 才能發表，請參閱 [常見問題](#) 以了解更多詳細訊息。此項要求是為了提高作者的能見度，確保正確歸屬並協助姓名規範化。

## 大會組織

大會主席	Iris Hui-Ru Jiang (National Taiwan University)
指導委員會主席	David Chinnery (Siemens Digital Industries Software)
議程主席	Gracieli Posser (Cadence Design Systems)
出版主席	Stephan Held (University of Bonn)
公關主席	Tung-Chieh Chen (Maxeda Technology)
財務主席	Joseph Shinnerl (Siemens Digital Industries Software)